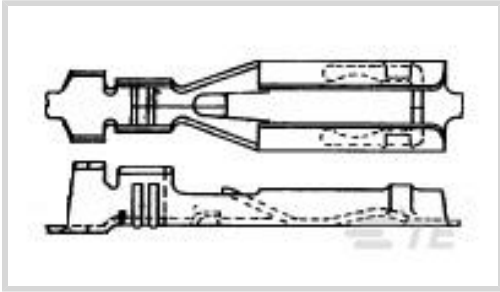




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡铅

壳体內的端子定位力: 带有

壳体內的端子定位器类型: 卡口

产品特性

接触件特性

端子形状和构造	正方形
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 20
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.76 – 76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀厚度	.76 – 76 μm[100 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直角
端子底板材料	锡

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

载带安装方向	侧进料
壳体內的端子定位器类型	卡口
带导线绝缘	带有



尺寸

线径	.8 – .9 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.14 – 1.83 mm, 1.7 – 2.28 mm[.067 – .09 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

产品图纸

[AMP BLADE II RECP PLTD 30 DPLX](#)

英文版本